

株式会社東京精密 2022年度(2023年3月期) 決算説明会

2023年5月12日

代表取締役会長 CEO	吉田 均
代表取締役社長 COO	木村 龍一
代表取締役副社長CFO	川村 浩一
取締役 計測社カンパニー長	塚田 修一

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。
- 2022年度より、在外子会社の収益及び費用は、従来の期末レートから期中平均レートにより円換算する方法に変更しております。これに伴い、補足資料の2021年度の数値は、期中平均レートを遡及適用した数値を記載しております。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2022年度 業績説明
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 初年度総括
- ◆ 2023年度業績前提、予想
- ◆ 質疑応答

2022年度 連結業績



通期業績(億円)	2021年度		2022年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	1,861		1,363		-27%
売上高	1,307		1,468	+18	+12%
営業利益 (営業利益率)	283 (22%)		345 (24%)	+45	+22%
経常利益	292		353	+42	+21%
当期純利益	213		236	+16	+11%
1株配当	185円		235円	+17円	+50円

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	414	464	556	427	462	340	301	260	-14%	-39%
売上高	288	324	314	381	279	432	320	437	+36%	+15%
営業利益 (営業利益率)	60 (21%)	69 (21%)	63 (20%)	91 (24%)	57 (20%)	100 (23%)	74 (23%)	114 (26%)	+53%	+24%
経常利益	60	70	65	97	65	101	71	116	+64%	+20%
当期純利益	44	53	48	70	48	71	33	84	+151%	+20%

➤ 2期連続で売上高・各利益の既往ピークを更新

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 代表取締役社長COO の木村です。日頃大変お世話になっております。
- それでは、2022年度の業績説明に入らせていただきます。
2022年度は、3期連続の増収増益、2期連続での既往ピーク更新となりました。
- この結果を受け、通期配当予想を1株235円といたしました。
詳細は、本日の適時開示をご覧ください。
- 第4四半期の業績は、下段に記載の通りで、売上高は四半期 既往ピークとなりました。
- なお、好業績を実現した従業員の労に報いるため、
全従業員へ期末賞与を支給しました。全体で おおむね10数億円となります。

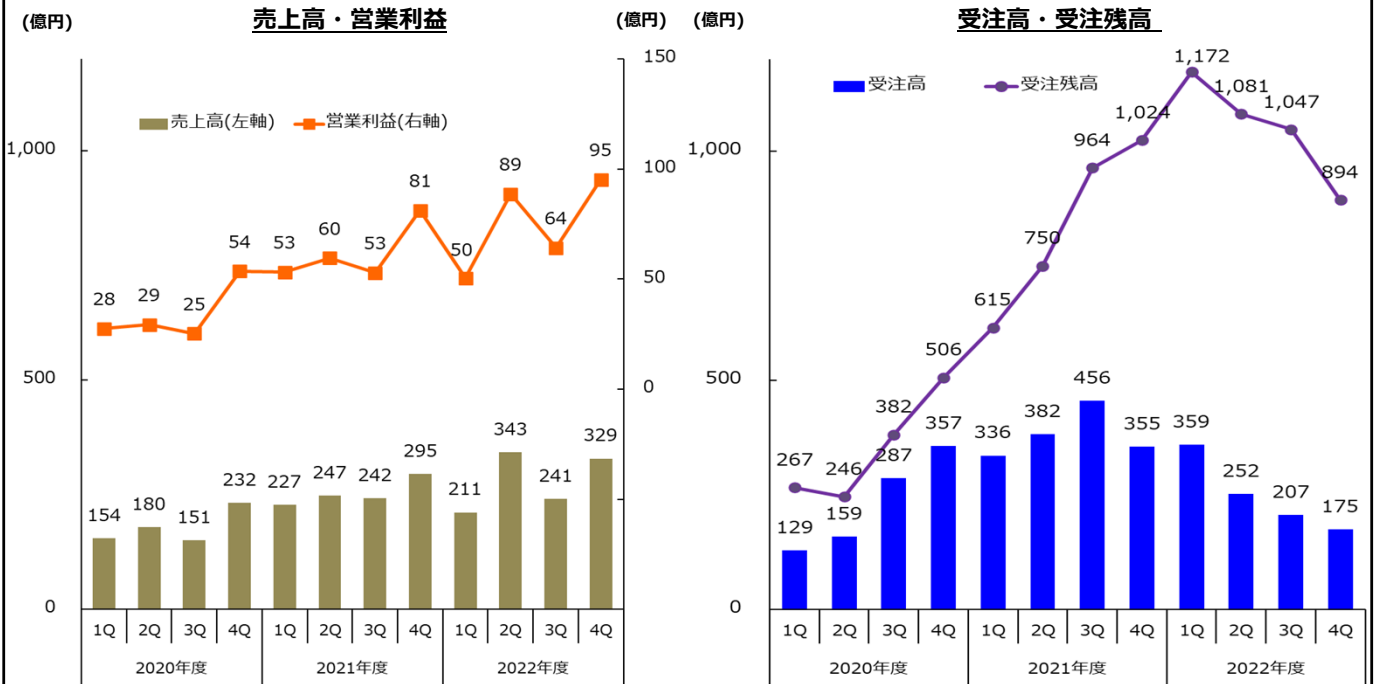
セグメント業績 (通期：億円)	2021年度		2022年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	1,529		994		-35%
売上高	1,011		1,124	+14	+11%
営業利益 (営業利益率)	247 (24%)		299 (27%)		+21%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	336	382	456	355	359	252	207	175	-15%	-51%
売上高	227	247	242	295	211	343	241	329	+37%	+12%
営業利益 (営業利益率)	53 (23%)	60 (24%)	53 (22%)	81 (28%)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	+48%	+17%

- 売上、利益は既往ピーク更新、受注は減少傾向が続いた
- 第4四半期は計画通り着地、受注は想定並みの減少

- こちらは、半導体製造装置セグメントの業績です。
- 通期受注は前年度比で減少しましたが、
高水準の生産、出荷が続き 売上高、営業利益は既往ピークとなりました。
営業利益率は27%となりました。
- 第4四半期の業績は下段に記載の通りです。

半導体 - 四半期業績推移



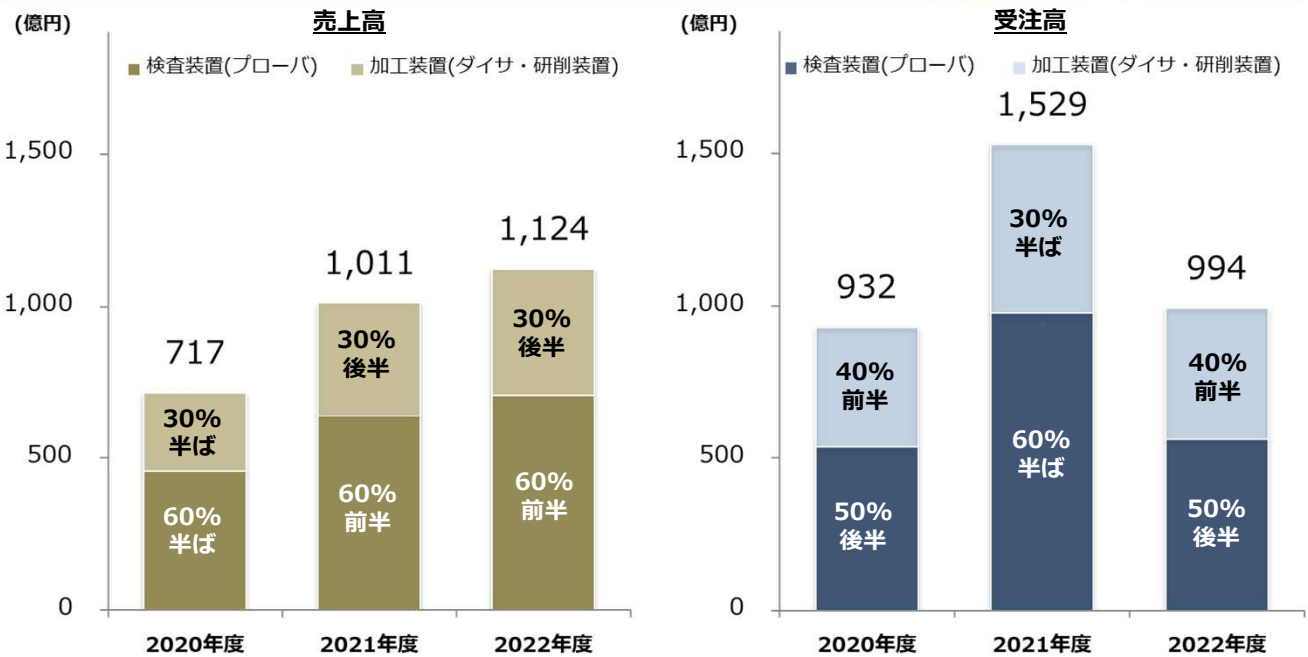
- 売上高：納期調整要請はあるも、前倒し案件のロット調整で補完
- 受注・受注残高：民生中心に減速傾向が続く（受注残高の一部を整理(約20億円)）

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

6

- こちらは、半導体の四半期推移グラフです。
- 左側のグラフで、第4四半期の売上高は、生産ロットの調整が滞りなく進み高水準となったほか、製品の利益率改善などもあり、営業利益も増加しました。
- 右側、受注高ですが、第4四半期は、民生向けの減速傾向が続く一方、パワー、SiC、アナログ、イメージセンサなどの需要は堅調に推移しました。
- このほど受注済案件の精査を行い、売上の実現性が低いと判断したものを整理いたしました。これにより、第4四半期の受注高、受注残高が20億円程度減少しております。



- 売上高：構成に変化はない
- 受注高：検査装置比率が減少も、加工装置堅調に推移

- 半導体製品別売上高、並びに受注高はご覧の通りです。
- 右側、受注高ですが、検査装置は、民生需要減少の影響が目立ちましたが加工装置は、ウェーハ向け、SiCなど、グラインダの需要が強かったため、軽微な減少にとどまりました。

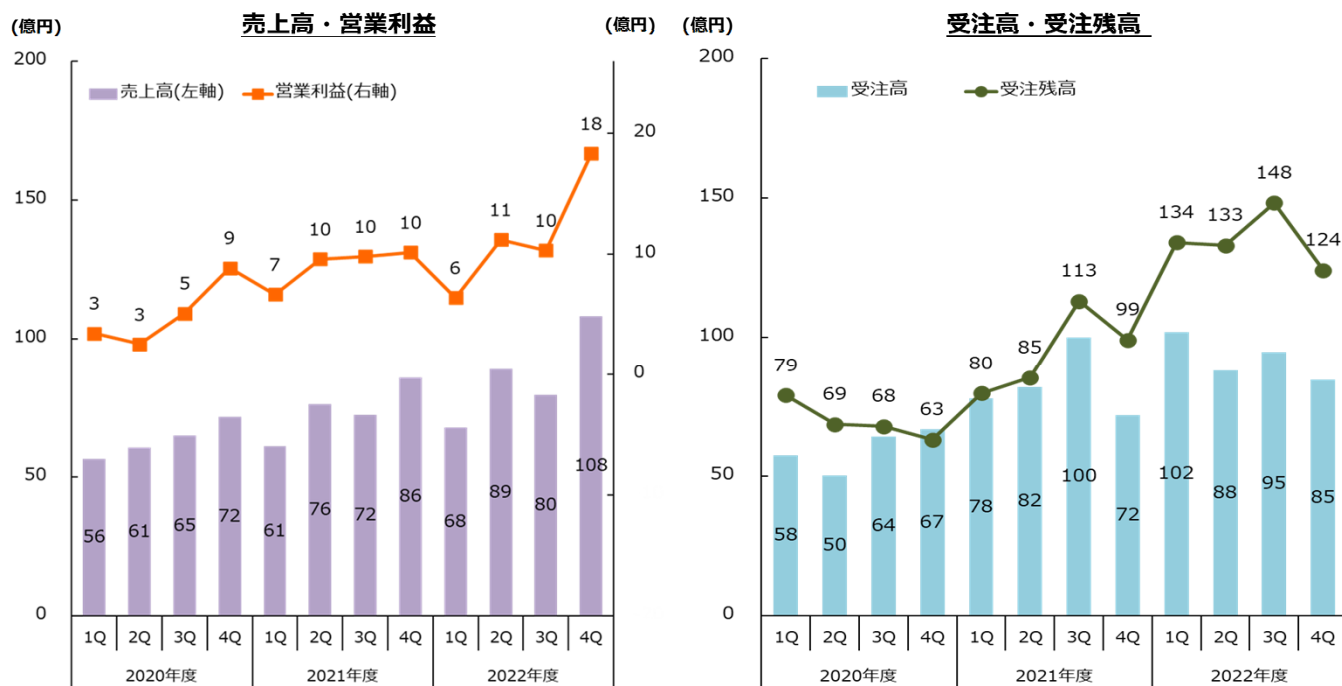
セグメント業績 (通期：億円)	2021年度				2022年度				前四半期比	前年同期比
	通期				通期					
受注高	332				370					+11%
売上高	296				344				+4	+17%
営業利益 (営業利益率)	36 (12%)				46 (13%)					+28%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	78	82	100	72	102	88	95	85	-11%	+18%
売上高	61	76	72	86	68	89	80	108	+36%	+26%
営業利益 (営業利益率)	7 (11%)	10 (13%)	10 (14%)	10 (12%)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	+78%	+81%

- 通期受注高・売上高は既往ピーク更新
- 第4四半期は売上高・営業利益ともに伸長

- 続いて、計測機器セグメントの業績説明です。
- 内需のものづくり需要でゆるやかな回復傾向が続いたほか、非自動車分野、例えば半導体、医療、ロボット等の需要を獲得できたことで受注高・売上高ともに既往ピークを更新しました。
- 第4四半期の業績は、下段に記載の通りです。

計測 - 四半期業績推移



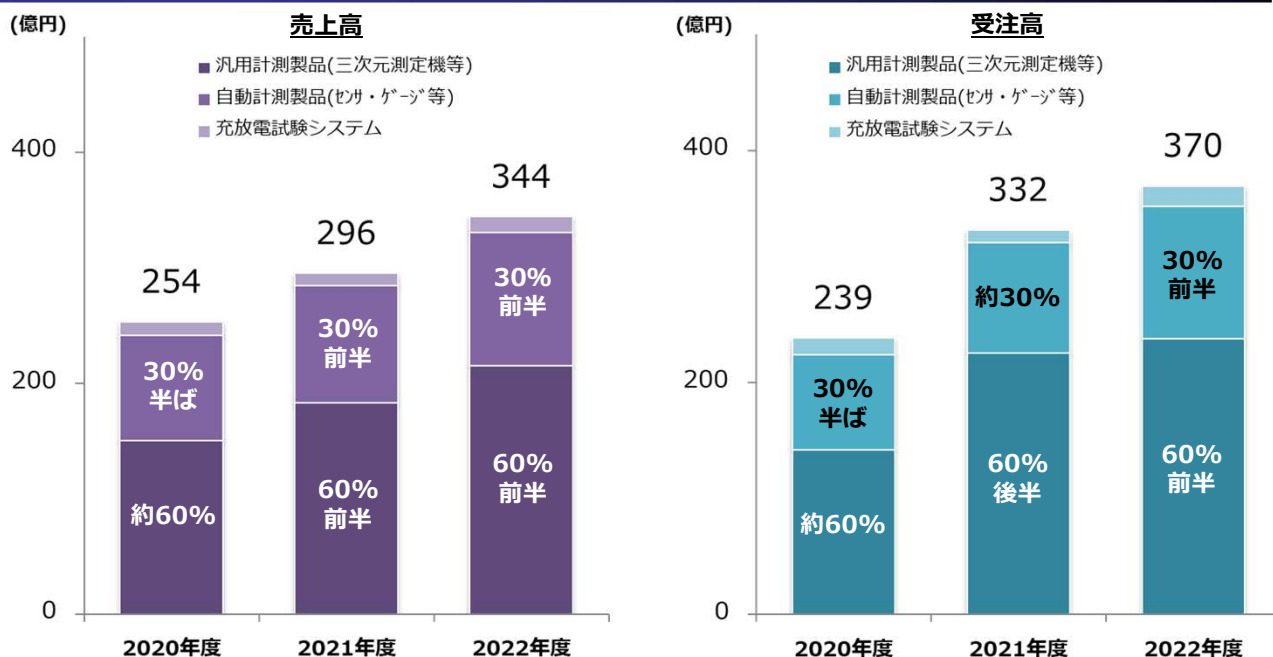
- 売上高・営業利益：出荷・検収が計画通り推移、営業利益も伸長
- 受注高：内需・ものづくり需要を獲得も、けん引していた半導体関連需要が停滞

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

9

- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高・営業利益ですが、この第4四半期は、長納期の案件も含む 出荷・検収が想定通り進み増収増益となりました。
- また右側、受注高についてですが、第4四半期は、これまでけん引していた 半導体関連需要が停滞により、想定を若干下回りました。



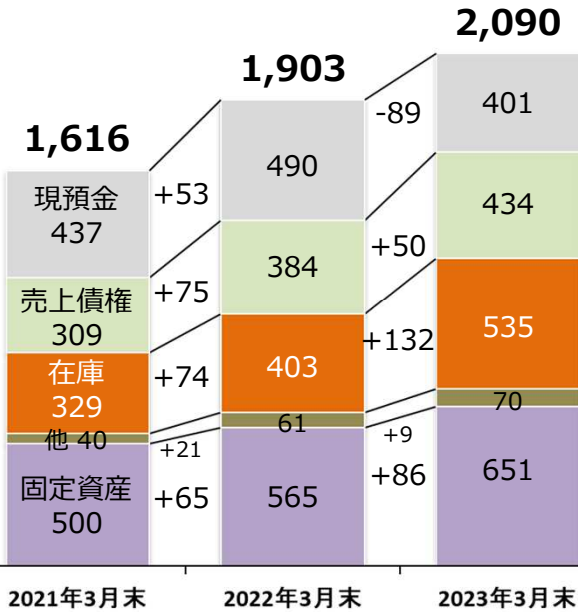
- 売上高：構成に変化はない
- 受注高：全体的に回復基調、充放電試験システム受注も寄与

- 計測製品別売上高、並びに受注高はご覧の通りです。
- なお、今回の説明より、自動計測製品と合算して表記していた充放電試験システムについて個別表記することといたしました。
- 充放電試験システムについては、評価受託ビジネスが堅調に推移しています。

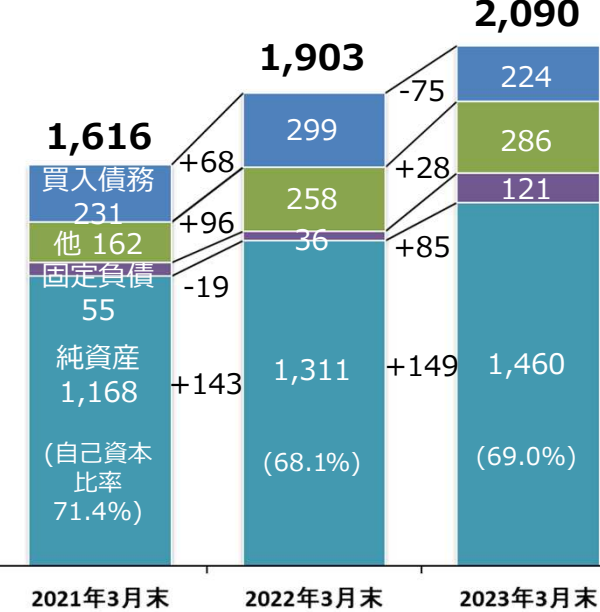
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



- 資産の部：在庫増加 (安全在庫増加、出荷対応)
- 負債・純資産の部：買掛減少(サイト短縮)、長期借入金増

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

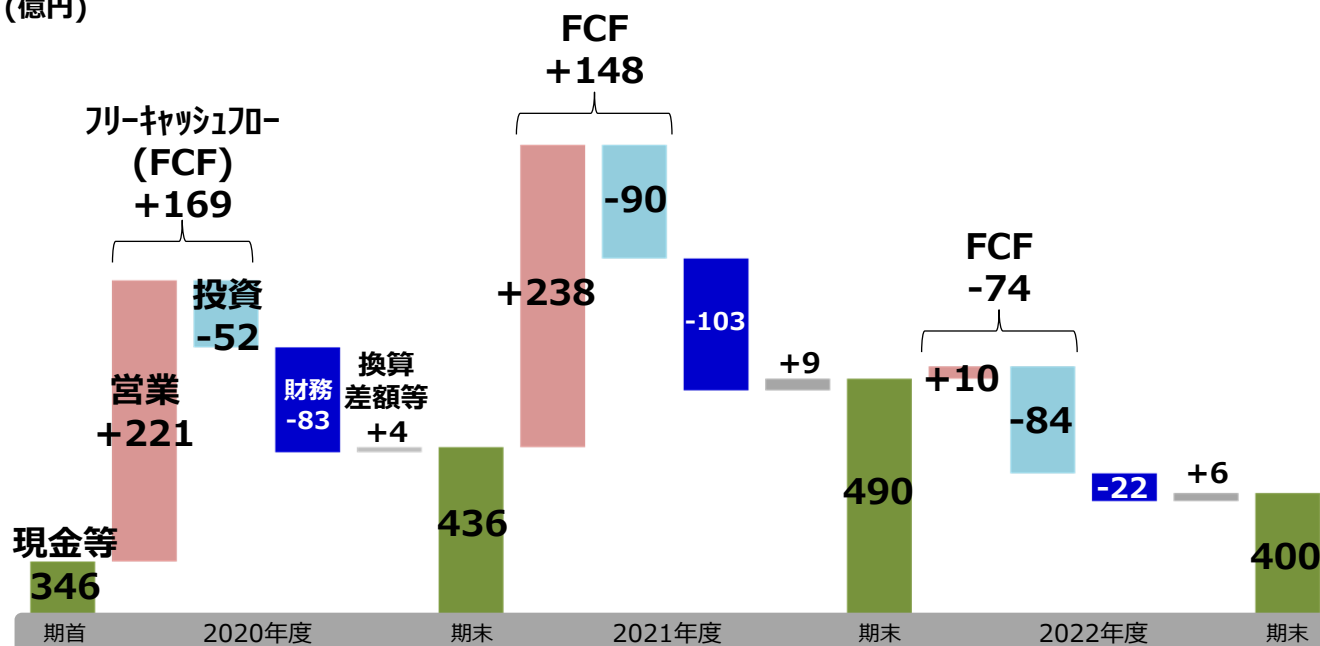
11

- こちらは貸借対照表の説明になります。
- 2023年3月末の総資産は、2,090億円となりました。
左の資産の部では、仕入先への支払いを早めた結果、買掛サイトが短縮し、現預金が減少しました。
一方で、売上増加に伴い売掛金が増加、安全在庫や今後の生産に向けた在庫も増加しました。
- 右側、負債については、買掛金が減少した一方で借入を実行し、固定負債が増加しました。
- 3月末の自己資本比率は 69.0%となりました。

キャッシュフロー(CF)



(億円)



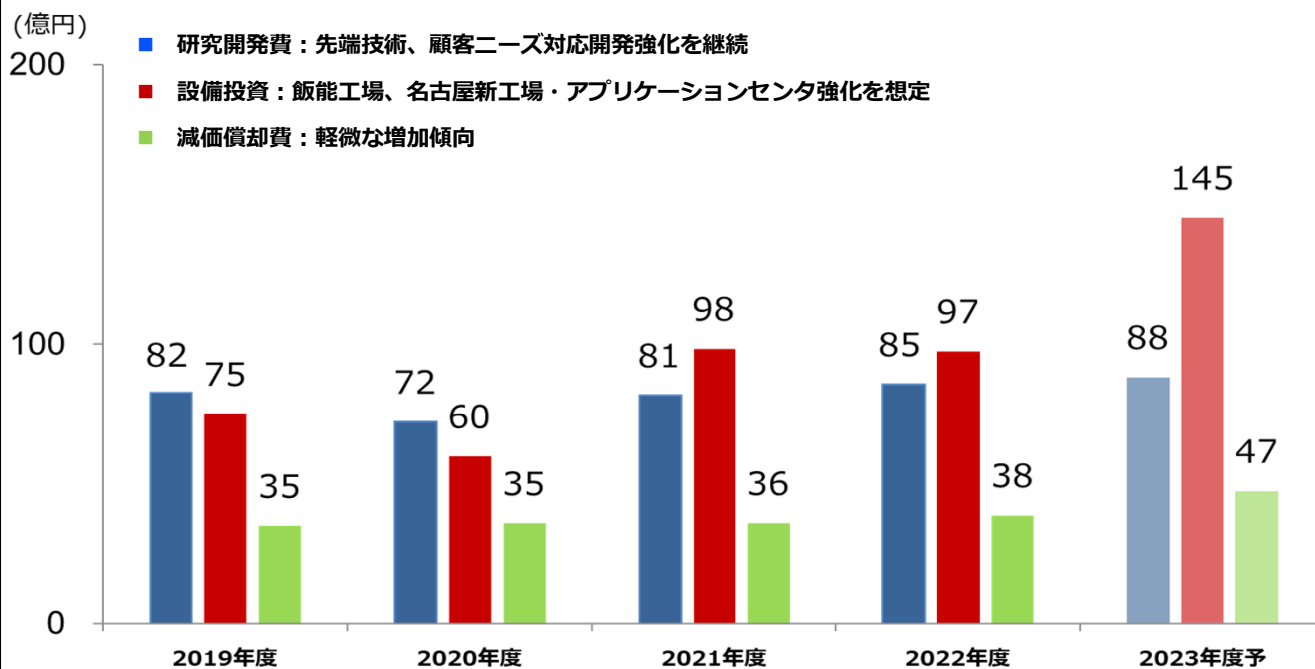
➤ 買掛金減少、売掛金・棚卸資産の増加により営業CFは減少

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

12

- 次に、キャッシュフローの概要です。右側が2022年度です。
- 営業活動キャッシュフローは、先ほど説明した買掛金の減少、売掛金と在庫の増加などがありプラス10億円で留まりました。
- 投資活動キャッシュフローは、マイナス84億円となり、フリーキャッシュフローはマイナス74億円となりました。
- 財務活動キャッシュフローは、自己株式の取得の一方で借入を実行した結果、マイナス22億円となりました。
- これにより、期末現預金残高は90億円減少して400億円となりました。



➤ 飯能工場および新工場(名古屋)に向けた工場投資を実施、生産キャパシティ拡張を継続

○ こちらは、試験研究費、設備投資、減価償却の実績と2023年度の計画です。

○ 2022年度実績はご覧の通りとなります。

設備投資は 計画の110億円に対して未達となりましたが
 検収タイミングのズレが主因であり、計画した投資は実行する予定です。

○ 2023年度計画は

試験研究費88億円、設備投資 145億円、減価償却費 47億円です。

○ ここまでが、2022年度実績の説明です。

次第

- ◆ 2022年度 業績説明
- ◆ **2022-2024年度 中期経営計画 初年度総括**
- ◆ 2023年度業績前提、予想
- ◆ 質疑応答

- 次に、2024年度を最終年度とする 中期経営計画について 初年度の総括をご説明いたします。

➤ 2024年度 定量目標を設定

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

➤ 全社取り組み

研究開発投資

先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化

生産キャパシティ拡充

飯能工場稼働 (2023年度)
SPEキャパシティ 1,400億+α
その次の工場投資も検討

環境投資

2030年CO2排出量 50%削減
(2018年度比)に向け
必要な投資を検討

投資評価指標

社内評価基準にROICを検討

アプリケーション強化

各国拠点におけるデモ設備強化

サステナビリティ

ESG各取り組み強化

- まずは昨年5月に開示した 定量目標を、改めてご説明いたします。
- ROE15%以上、売上高 1,700億円、営業利益 375億円と設定いたしました。
また、全社の取り組みを 下段にまとめております。

2022年度：ROE 17.3%, 売上高 1,468億円, 営業利益345億円

半導体	<ul style="list-style-type: none">➢ 高水準の生産・出荷を維持➢ 中長期を見据えた 生産キャパシティ拡張を実行<ul style="list-style-type: none">↳ 飯能工場: 2023年7月稼働予定、新工場(名古屋): 検討開始➢ 部材価格高騰の中、利益率25%以上を確保
計測	<ul style="list-style-type: none">➢ コロナ後需要・内需・非自動車向けの拡販を推進し、既往ピークの受注高・売上高➢ 充放電試験ビジネス 評価受託が堅調に推移
サステナビリティ	<ul style="list-style-type: none">➢ 統合報告書の発行(パーパスの策定・公表)<ul style="list-style-type: none">↳ 当社の企業価値の再確認 「“計測技術”を持つ唯一のSPEメーカー」➢ TCFDの枠組みに沿った気候変動対応戦略の策定・実行➢ 女性採用比率:18.3% (前年比+1.3pt) 女性従業員比率:8.5%(同+1.1pt)➢ 従業員エンゲージメントサーベイ実施➢ 人権方針の制定・開示、人権デューデリジェンス(DD)の取り組み開始➢ マルチステークホルダー方針の策定・開示

- こちらは、初年度の総括です。定量面は、上段に記載の通りです。
- 半導体は、高水準の出荷を維持し、
将来を見据えた生産キャパシティの拡張にも取り組みました。
飯能工場に加え、名古屋工場の検討を開始しております。
また 製品の付加価値を高めることで、利益率が上昇しました。
- 計測は、内需、非自動車向けに拡販を推進したほか
充放電試験システムの評価受託ビジネスが軌道に乗りました。
- サステナビリティでは、当社としては初めての統合報告書を発行し、
当社は「“計測技術”を持つ唯一の半導体製造装置メーカー」であるという
企業価値を発信しました。
- その他、投資評価指標としての事業別ROIC(ローイック)・WACC(ワック)を策定、
今後社内活動に活かしていく予定である他、環境、人財、マルチステークホルダーに
関して取り組みを実施しました。

- 初年度は ほぼ想定通りの成果
- 2023年度は、半導体を中心に減速を想定するが、
当社の事業領域における2024年度の 市場回復の可能性は
高いと考える
- よって、ジャンプアップに必要なアクション
(研究開発投資、設備投資等)は継続する



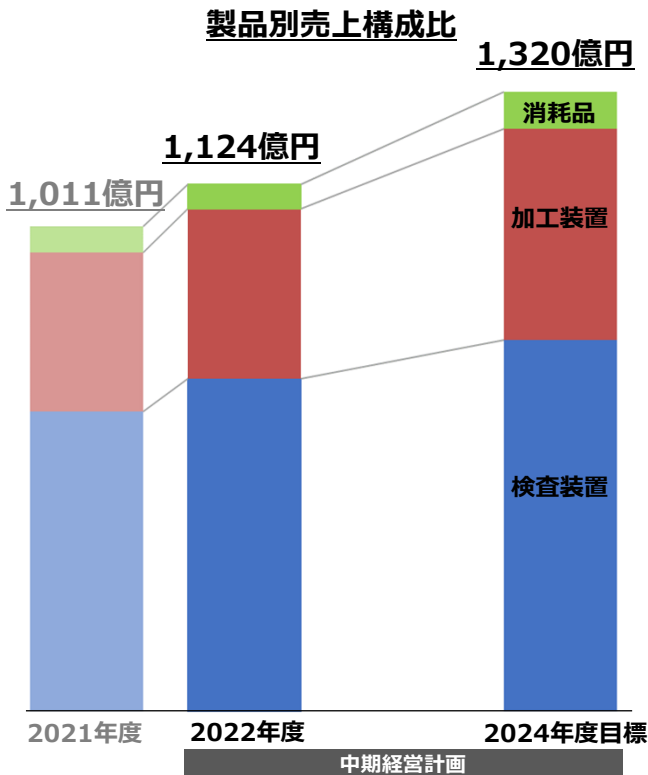
May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

17

- 初年度は想定通りの成果となりましたが、
2023年度は、半導体市場を中心に減速が避けられない状況となっています。
- 一方で、後ほど説明いたしますが、
2024年度の市場回復の可能性は高いと考えております。
- そのため、確実なジャンプアップのために、
引き続き、研究開発投資、設備投資などの必要な準備を進めて参ります。
- 次に、セグメント別に、ご説明いたします。

◆ 初年度総括
◆ 今後の戦略



消耗品

- ◆ 全般に軟調も、研削系消耗品需要拡大で横ばい維持
- ◆ 消費量が多いSiC向け砥石需要の取り込み、強化

加工装置(ダイサ・グラインダ)

- ◆ SiC向け/ウェーハ用に高水準の需要
- ◆ アブレーションレーザダイサ販売開始
- ◆ SiC/GaN・アドバンストパッケージ向け、ウェーハ用 グラインダ強化
- ◆ アブレーションレーザダイサ販売推進

検査装置(プローバ)

- ◆ 高付加価値分野に注力、デパート化推進による用途拡大(HPC、パッケージ、メモリ、パワーデバイス等)の実行
- ◆ ハイエンド分野で高付加価値を提供

長期戦略に基づく半導体×計測シナジー効果

- ◆ 計測ビルトインモデル販売開始
- ◆ 半導体計測シナジー効果強化

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

18

- こちらが、半導体製造装置の、進捗と今後の戦略をまとめたものです。
右側、青いひし形で示しているのが、2022年度の総括、赤いひし形が今後の戦略です。
- 消耗品は、全体的に軟調ではあったものの、
グラインダ消耗品が堅調に推移し、横ばいとなりました。
今後、消費量が多いSiC向けの砥石需要も期待できます。
- 加工装置は、SiCやウェーハ製造向けグラインダが堅調に推移しました。
また、アブレーションレーザダイサの販売を開始しました。
- 検査装置、プローバは、デパート化による用途拡大を進めました。
また、高精度温度制御が必要なハイエンドロジック向けで
さらに付加価値を提供していきます。
- さらに、半導体と計測事業の融合によるシナジー効果があります。
初年度は、計測機器を搭載したビルトインモデルの販売を開始しました。

➤ 現在当社を取り巻く技術トレンドは、現中計及びそれ以降も主要な事業機会となる

技術トレンド

当社の事業機会

脱炭素化に向けた
パワー半導体 (SiC/GaN) の革新

- SiC等の難削材加工需要増加
 - 高効率アウトプット・高精度加工の両立
 - ↳ 高剛性グラインダ
 - ↳ エッジグラインダ
 - ↳ CMP

Society5.0の実現に向けた
高機能デバイス台頭
半導体・電子部品の数量増加

- 測定時間増加ならびに検査難度の上昇
 - 検査に関する付加価値の上昇 (温度対応、スループット改善)
 - ↳ プローバ
- 高精度加工の需要増加
 - 高効率アウトプット・高精度加工の両立
 - ↳ ポリッシュグラインダ
 - ↳ アブレーションレーザダイサ
 - ↳ 計測ビルトインモデル → 次期中計においては成長が期待

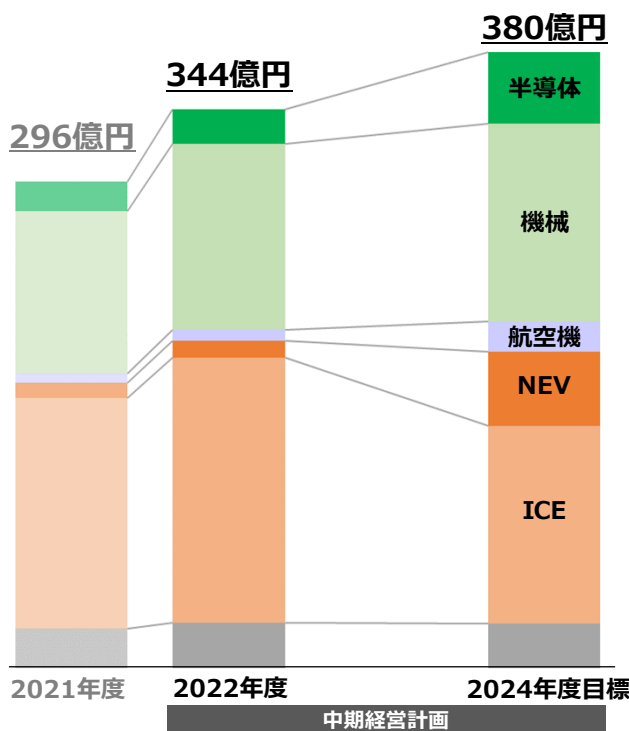
微細化の限界に伴う
三次元実装(アドバンスパッケージ)拡大

- 高精度研磨加工の需要増加
 - 高効率アウトプット・高精度加工の両立
 - ↳ ポリッシュグラインダ
 - ↳ エッジグラインダ・ブレードダイサ (トリミング)
- 貼り合わせ加工の精度要求の高まり
 - テスト工程数の増加
 - ↳ プローバ

- あわせて、半導体事業の技術トレンドと、当社の事業機会をご説明いたします。
- まず、脱炭素化に向けたパワー半導体の革新により、SiC等の難削材加工需要の高まりが想定されます。
当社は SiCプロセスに適した研削装置を多数有しており、今後の成長が期待できます。
- 次に、Society5.0の実現に向けた高機能デバイスの台頭と、半導体・電子部品の数量増加が想定されます。
デバイスの高度化により、検査難度の上昇、検査時間の増加が考えられ、当社の強みであるカスタマイズ力が活かされると考えています。
- また、高精度の加工が要求され、当社の加工装置においても恩恵があると考えています。
特に、アブレーションレーザダイサや、加工時に測定も行える、計測機器ビルトインモデルの成長が期待できます。
- 最後に、微細化の限界に伴う三次元実装の拡大です。
こちらは高い貼り合わせ加工精度が要求され、加工装置の需要、検査需要の増加が見込まれます。

◆ 初年度総括
◆ 今後の戦略

製品別売上構成比



半導体向け

- ◆ 半導体向け非接触計測機器、汎用計測機器の開拓
- ◆ 半導体向けの需要開拓、ソリューション展開継続

機械・航空機向け

- ◆ 航空機向け専用機のリリース
- ◆ 医療向け非接触式計測機器の開発・強化
- ◆ 非接触シャフト測定機拡販
- ◆ 自動化需要に向けた、機器・SW・サービスを含めたトータルソリューション展開

NEV向け

- ◆ EVギア・モータ等の部品物理測定、バッテリーX線CT測定需要の開拓
- ◆ 充放電 電池評価受託サービスはフル稼働維持
- ◆ EV向け計測のトータルソリューション展開

ICE向け

- ◆ 回復は緩慢も、安定的な需要
- ◆ 更新需要案件取り込み
- ◆ 自動化ソリューション、保守点検業務強化

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

20

- こちらは、精密計測機器の進捗と今後の戦略をまとめたものです。
- 半導体向けは、半導体メーカーならびに製造装置メーカーへの開拓を行いました。引き続き、需要の開拓を進めます。
- 機械・航空機向けは、航空機部品測定用三次元座標測定機のリリースや、医療向け非接触測定機器の開発強化などの展開を行いました。
- また、ものづくりの自動化に向けた需要獲得も進めており、機器、ソフトウェア、サービスを含めたトータルソリューションを展開していきます。
- NEV向けは、部品の物理測定、バッテリーの電気測定のほかバッテリー内部をX線CTで測定するソリューションの提供を開始しました。今後はEV向けトータルソリューションを展開していきます。
- 最後に、ICE向けは、安定的な更新需要があり、こちらを確実に獲得していきます。

➤ 現在当社を取り巻く技術トレンドは、現中計及びそれ以降も主要な事業機会となる

技術トレンド

当社の事業機会

カーボンニュートラルに向けた
電動車・電動化技術の市場拡大

製品品質の要求度の高まり
(工程内で品質を作り込む
不良品を後工程に流さない)

拡大する成長分野での
新たな計測技術のニーズ
(半導体、航空機、医療分野等)

・計測需要の変化

- 高精度長さ計測、電気計測、内部欠陥/不純物評価
 - └ 各種高精度計測機器製品群
 - └ 充放電試験システム
 - └ X線CT装置

・全数検査・現場計測需要の拡大

- 自動化対応、プロセスコントロール、ネットワーク/稼働監視
 - └ インライン用 三次元座標測定機
 - └ 工作機械等の加工機用センサ
 - └ データ管理ソフトウェア

・非接触測定技術の需要拡大

- 高分解能、高速を実現する非接触センサ技術
 - └ 白色干渉顕微鏡
 - └ 非接触距離センサ
 - └ 各種計測機用非接触レーザ/画像センサ等

- 計測事業の技術トレンドと、当社の事業機会をご説明いたします。
- まず、カーボンニュートラルに向けた電動車・電動化技術の市場拡大が想定されます。物理計測に加えて、電気計測、内部欠陥などの評価が求められ、各種計測機器の成長が期待できます。
- また、高精度検査需要そのものの拡大のほか、製造工程の自動化によるインライン計測、工作機械等の加工機用センサの成長が見込まれます。
- 最後に、非自動車、半導体、航空機、医療などの新たな計測技術のニーズの拡大が想定されます。こちらでは主に非接触測定の商品の成長が期待されます。

➤ 生産キャパシティ拡張 (工場投資)を計画通り実施



飯能工場 (埼玉県) 2023年7月稼働予定
プローバ中心の生産体制



名古屋地区 新工場

2025年度竣工を目途に検討中
グラインダ中心の生産体制

➤ そのほか 世界各地のアプリケーションセンタ拡張を展開

- また、設備投資も、中長期目線を見据えております。
- この先の半導体需要を踏まえると 生産キャパシティの拡張が必須と考えております。
飯能工場は、今年7月に稼働を開始する予定です。
プローバを中心とした生産体制を計画しております。
これにより、キャパシティが2021年度対比で約50%アップし
中期経営計画の達成に必要なキャパシティを充足する予定です。
- また、2月の説明会でも申し上げたように、名古屋地区で
グラインダの生産を中心とした工場を検討しております。
こちらは、2025年度を目途に稼働させる予定です。
- さらに、全世界でのアプリケーションセンタの拡張も並行して行って参ります。

基本的な考え方



中期キャッシュアロケーション 目途

試験研究費

- 売上高試験研究費比率 10%

設備投資

- 通常時：EBITDA * 25%内
- Max時：EBITDA * 50%
(EBITDA = 営業利益 + 減価償却費)

株主還元

- 配当：配当性向 40%を目安に実施
- 投資動向などを勘案し 自己株取得

M&A等

- FCF マイナスにならないよう配慮

- 資本効率については、昨年度の中期経営計画説明会でご説明した左側の基本的な考え方に従い、今後も、中期的なキャッシュアロケーションの目途を取り決めて参ります。
- 試験研究費は、売上高の10%程度を目安としております。今後の成長の源泉となりますので、引き続き強化して参ります。
- 設備投資は、今後の市場成長を想定したキャパシティの拡張を重点的に行う観点から、マックスと設定した水準での投資を行う予定です。
- 株主還元は、配当性向 40%を目安として実施を継続します。自己株式の取得は、投資動向などを総合的に勘案し 決定します。
- M&A等は、原則としてフリーキャッシュフローがマイナスにならない範囲で検討していきます。

マテリアリティ	2022年度 優先的な取り組み	2023年度 優先的な取り組み
環境問題を解決する製品・事業活動 提供した 製品・サービスによる環境貢献	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 環境配慮型製品開発 (SCOPE 3 削減、含有化学物質管理) ➢ 温暖化防止防止 (CO2排出削減、省エネ) ➢ 廃棄物削減、資源再利用 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ CO2排出量削減(設備・機器効率化、太陽光発電導入) ➢ 電力・水・紙使用量削減 ➢ 環境配慮型製品の開発 ➢ 飯能工場の節電・節水
社会課題を解決する高付加価値製品・サプライチェーンの構築	<ul style="list-style-type: none"> ➢ クリーンテック ➢ 自社生産～自社検査システムによる品質改善・保証 ➢ 遠隔サポートの導入 ➢ サプライヤ協力関係構築 ➢ BCPの取り組み 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 品質管理の高度化 ➢ 化学物質管理の厳格化 ➢ サプライチェーンの強化
多様な人々が活躍でき、心身ともに健康で働き甲斐のある職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 女性活躍推進 (採用促進、定着、育成) ➢ 主体的に学べる機会提供 ➢ 健康経営 (2035年目標) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 健康と安全の向上 ➢ ダイバーシティ推進 ➢ 人材育成推進 ➢ エンゲージメントの向上
企業活動を支える経営基盤・コンプライアンス・リスクマネジメントの強化	<ul style="list-style-type: none"> ➢ コンプライアンス強化 ➢ 情報セキュリティ強化 ➢ 事業継続計画強化 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 内部統制機能の維持・向上 ➢ 企業倫理・法令遵守の厳格化 ➢ 適時・適切な情報開示 ➢ 健全な内部通報制度運営維持 ➢ 効果的なコンプライアンス教育 ➢ 事業継続計画高度化
人権の尊重	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 人権尊重意識の高揚 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 人権教育の実施 ➢ 人権デューデリジェンスの実施 ➢ 救済システムの構築

- また、サステナビリティの取り組みも強化して参りました。
こちらは、中期経営計画の中でマテリアリティとしたもの、
2022年度の実績、および2023年度の優先的な取り組みについてまとめたものです。
- 環境に関しては、当社のサステナビリティサイトにも開示したように
2030年のCO2排出量を2018年度対比で、
50%削減することなどを目標に活動を行います。
- また、サプライチェーンの強化、働きがいのある職場づくり、
コンプライアンス・リスクマネジメントの強化、
人権尊重への取り組みなど、活動を続けて参ります。
- ここまでが、中期経営計画 初年度の総括になります。

次第

- ◆ 2022年度 業績説明
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 初年度総括
- ◆ 2023年度業績前提、予想
- ◆ 質疑応答

○ 続きまして、2023年度の業績予想についてご説明いたします。

全体

- 高水準の生産が続くと想定
- 部材不足は一部を除き 緩和へ
- 半導体の輸出関連規制の動向を注視

半導体

- 上期受注は、民生品需要を背景に軟調、下期に緩やかな回復
- 次のアップターンを見据え、生産キャパシティ拡張、研究開発、アプリケーション強化に取り組む

計測

- 内需は全般に安定
- 自動車向けはICEの緩やかな回復/NEVの急拡大を想定
- 非自動車分野への拡販や、自動化向けソリューション強化を進める

- まず、業績予想の前提です。
- 全体では、高水準の生産が続くほか、昨年まで発生していた部材不足も、一部を除き、緩和する想定です。
- 一方で、半導体製造装置の輸出関連規制の影響は、現時点で定量的に見積もることは困難ですが業容に影響する可能性があり、その動向を注視する所存です。
- また半導体の受注については、上期は引き続き軟調と考えています。しかし、在庫調整がひと段落するタイミングや、次の技術革新をトリガーに、下期にはゆるやかに回復してくると想定しております。その間、次のジャンプアップに向けて、必要な投資を続けていきます。
- 計測では、内需全般のものづくりの需要は安定するとみられ、引き続き、非自動車分野等への販路拡大を進めます。

2023年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2022年度			2023年度予			
	上期	下期	通期	上期予	下期予	通期予	前期比
売上高	711	757	1,468	610	680	1,290	-12%
営業利益 (営業利益率)	157 (22%)	188 (25%)	345 (24%)	110 (18%)	130 (19%)	240 (19%)	-30%
経常利益	166	187	353	110	130	240	-32%
当期純利益	119	117	236	80	90	170	-28%
1株配当			235円			170円	-65円

セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	612	382	994				
	売上高	554	570	1,124	440	500	940	-16%
(計測)	受注高	190	179	370				
	売上高	157	188	344	170	180	350	+2%

- 全般に下期に緩やかな回復を想定した予想
- 前提為替レート 米ドル：130円 1ドル1円の円高で △1.2億円程度の影響

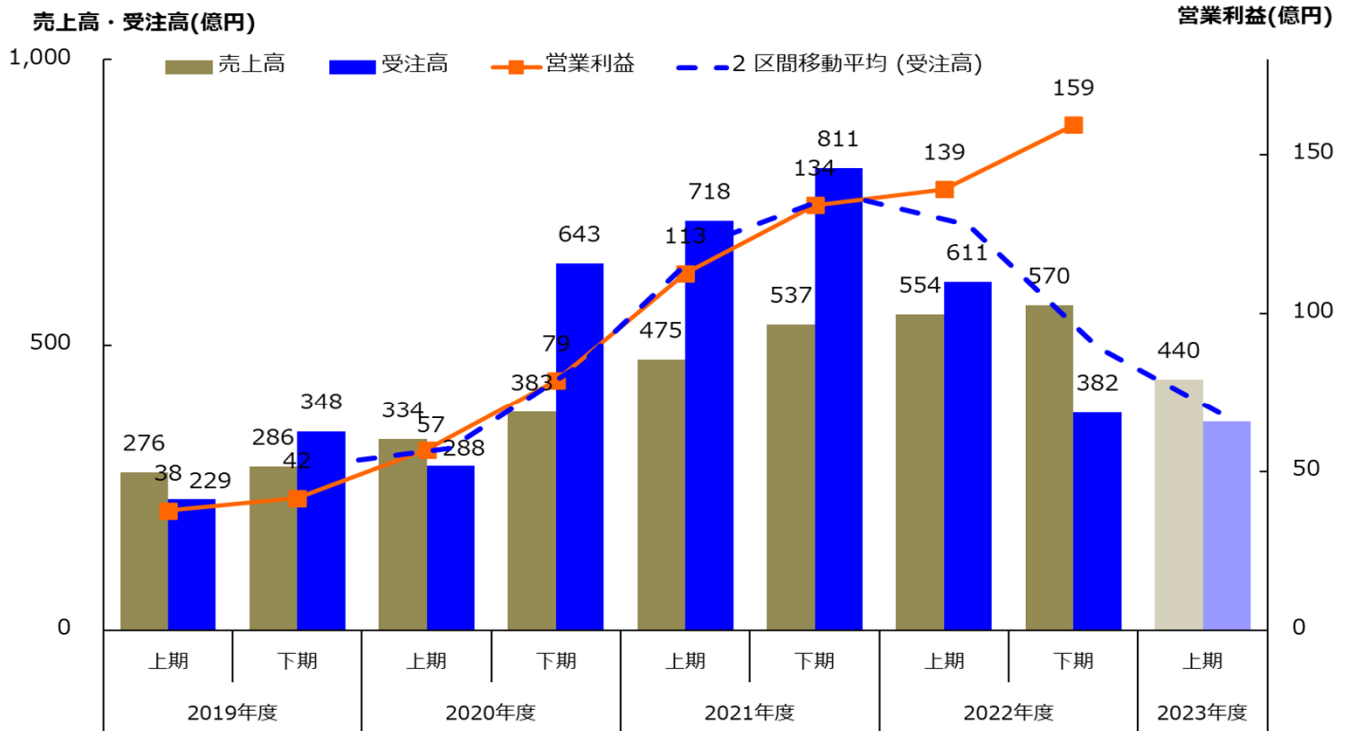
May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

27

- これらの前提を踏まえた2023年度の業績予想はご覧の通りです。
- 売上高 1,290億円, 営業利益240億円, 経常利益240億円, 当期純利益170億円を見込んでおります。
- 先ほど申し上げたように、半導体では上期はやや軟調に推移、下期に向けてゆるやかに回復する想定を持っております。
- 前提為替レートは、1ドルが130円です。
海外への出荷が増加していることなどから、為替影響が若干増加しており、現時点では、1ドル1円の円高で、年間1.2億円程度の減益影響を想定しています。
- このほか、売上減による利益減少、人件費の上昇などを想定した予想です。
- なお配当については、年間で1株170円を予想しております。

半導体 - 売上・受注高 見込



➤ 受注高は前年下期横ばいを想定するも、下期には回復を見込む

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

28

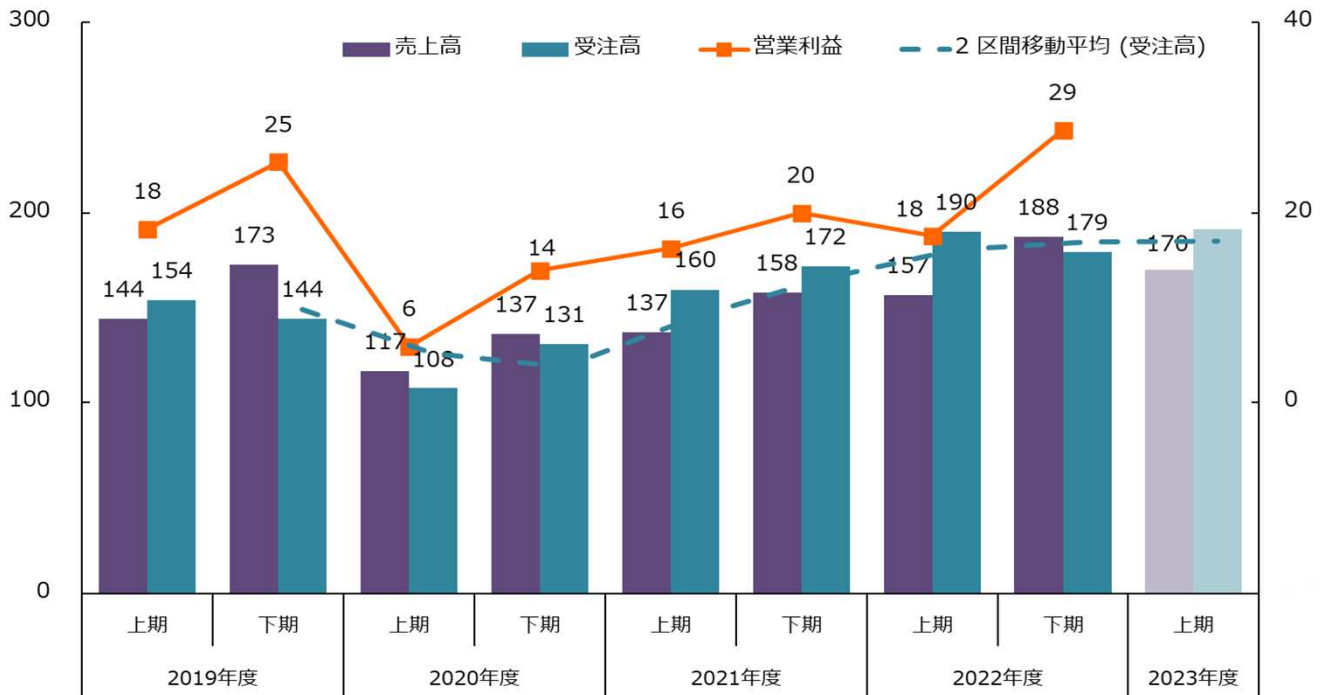
- こちらは、半導体事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注高は、グラインダの受注が下支えとなることで、前年度下期対比 微減から横ばいの水準を想定しております。
- 上期予想の製品構成比は、
受注高は、検査装置 5割、加工装置5割、
売上高は、検査装置 6割、加工装置4割を想定しています。

計測 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



➤ 受注高は緩やかな回復傾向を維持

May 12th, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

29

- こちらは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注は、前年度と同様、ゆるやかな回復基調が続くと見込んでいます。
- 製品構成比は、
 売上高は 汎用計測 6割半ば、自動計測が3割、残りが充放電、
 受注高は 汎用計測 7割、自動計測が 2割前半、充放電が 1 割弱を想定しています。

➤ 今後の成長機会

Hybrid bondingによる研削装置の成長

プローバ高精度温度制御 → 付加価値の拡大

SiC加工は基板主体からデバイス主体へ

半導体と計測の融合によるシナジー効果 2025年 130億円超

NEVバッテリーの飛躍的な個数成長

- 最後に、今後の当社の成長機会についてご説明いたします。
- まず、ハイブリットボンディングの普及にむけ、この夏以降プロジェクトが活発になると想定しており、研削装置の成長が想定されます。
- プローバは、高精度温度制御による付加価値の拡大が挙げられます。
- SiCは、現在の基板加工を主体とした需要からデバイス加工が主体となるため、研削装置の需要がさらに拡大します。
- また、半導体と計測の融合によるシナジー効果について、2025年には130億円程度になると想定しております。
- 最後に、NEVですが、バッテリーの増加により、充放電試験システムに大きな事業機会が生まれます。
- 当社は、これらの事業機会を獲得し、業容の拡大を進めます。
- 私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。

次第

- ◆ 2022年度 業績説明
- ◆ 2022-2024年度 中期経営計画 初年度総括
- ◆ 2023年度業績前提、予想
- ◆ 質疑応答



IR情報



<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

統合報告書



https://ir.accretech.jp/ja/integrated_report.html

サステナビリティ情報



<https://www.accretech.jp/sustainability/index.html>

補足資料

Supplementary Data

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2022年3月期 FY2022/3				2023年3月期 FY2023/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	33,604	38,228	45,575	35,487	35,918	25,246	20,663	17,537
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	7,780	8,192	9,995	7,191	10,246	8,788	9,472	8,452
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	41,384	46,420	55,571	42,679	46,165	34,034	30,136	25,990
Backlog 受注残額	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	61,493	74,990	96,367	102,370	117,153	108,134	104,714	89,371
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	7,970	8,535	11,298	9,904	13,367	13,263	14,782	12,428
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	69,464	83,526	107,666	112,274	130,520	121,398	119,496	101,799
Sales 売上	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	22,729	24,731	24,198	29,485	21,135	34,264	24,084	32,880
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,111	7,627	7,232	8,585	6,783	8,892	7,954	10,806
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	28,841	32,358	31,431	38,071	27,919	43,156	32,038	43,687
OP 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,320	5,953	5,294	8,130	5,049	8,874	6,416	9,526
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	667	961	984	1,015	641	1,120	1,031	1,834
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,987	6,914	6,279	9,145	5,691	9,994	7,448	11,361
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.4%	24.1%	21.9%	27.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	10.9%	12.6%	13.6%	11.8%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.8%	21.4%	20.0%	24.0%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%

損益計算書 Statements of Income



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2022年3月期 FY2022/3				2023年3月期 FY2023/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	87,927	97,105	130,702	146,801	28,841	32,358	31,431	38,071	27,919	43,156	32,038	43,687
売上原価 Cost of goods sold	53,452	60,190	77,694	84,967	17,413	19,130	19,360	21,789	15,940	25,783	18,220	25,022
売上総利益 Gross Profit on Sales	34,474	36,914	53,008	61,834	11,428	13,227	12,070	16,281	11,978	17,372	13,817	18,664
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,192	21,351	24,681	27,339	5,440	6,313	5,790	7,136	6,287	7,378	6,369	7,303
営業利益 Operating profit	12,282	15,562	28,327	34,494	5,987	6,914	6,279	9,145	5,691	9,994	7,448	11,361
営業外収益 Non-operating income	255	540	987	965	134	66	175	611	824	96	-229	274
営業外費用 Non-operating expenses	177	235	153	162	110	27	-76	92	18	25	111	7
経常利益 Recurring Profit	12,360	15,867	29,160	35,297	6,011	6,953	6,531	9,664	6,496	10,065	7,107	11,628
特別利益 Extraordinary gains	57	1,354	390	103	13	-	-	377	5	58	12	25
特別損失 Extraordinary losses	1,712	1,074	34	2,099	-	-	-	34	-	-	1,751	347
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	10,705	16,147	29,516	33,301	6,024	6,953	6,531	10,007	6,502	10,124	5,368	11,306
法人税等合計 Total Income tax and others	3,598	3,978	8,132	9,607	1,651	1,688	1,753	3,038	1,660	3,019	2,011	2,916
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	7,156	12,175	21,326	23,630	4,356	5,250	4,755	6,963	4,812	7,096	3,338	8,383
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	171.89	293.83	522.52	581.33	106.09	128.30	117.06	171.34	118.38	174.47	82.05	206.60
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	170.72	291.43	517.51	575.62	-	-	-	-	-	-	-	-

貸借対照表 Balance Sheet



(百万円) (Million Yen)		2020年3月期 FY2020/3	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	34,640	43,657	49,033	40,080
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	29,633	30,946	38,367	43,403
	在庫 Inventories	30,152	32,886	40,325	53,482
	その他 Others	3,345	4,025	6,103	7,005
	合計 Total	97,771	111,516	133,829	143,972
固定資産合計 Total Fixed Assets		48,777	50,039	56,457	65,060
総資産 Total Assets		146,549	161,556	190,287	209,032
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	16,895	23,062	29,876	22,359
	その他 Others	12,121	16,233	25,765	28,588
	合計 Total	29,017	39,296	55,641	50,947
固定負債合計 Total long-term liabilities		7,857	5,482	3,564	12,057
負債合計 Total Liabilities		36,874	44,778	59,206	63,004
純資産合計 Total Net Assets		109,674	116,777	131,081	146,028
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		146,549	161,556	190,287	209,032
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		9,641	7,581	5,497	14,191
自己資本比率 Equity Ratio(%)		73.9%	71.4%	68.1%	69.0%
自己資本利益率 ROE(%)		6.7%	10.9%	17.4%	17.3%

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む

Incl. Electronically recorded obligations-operating

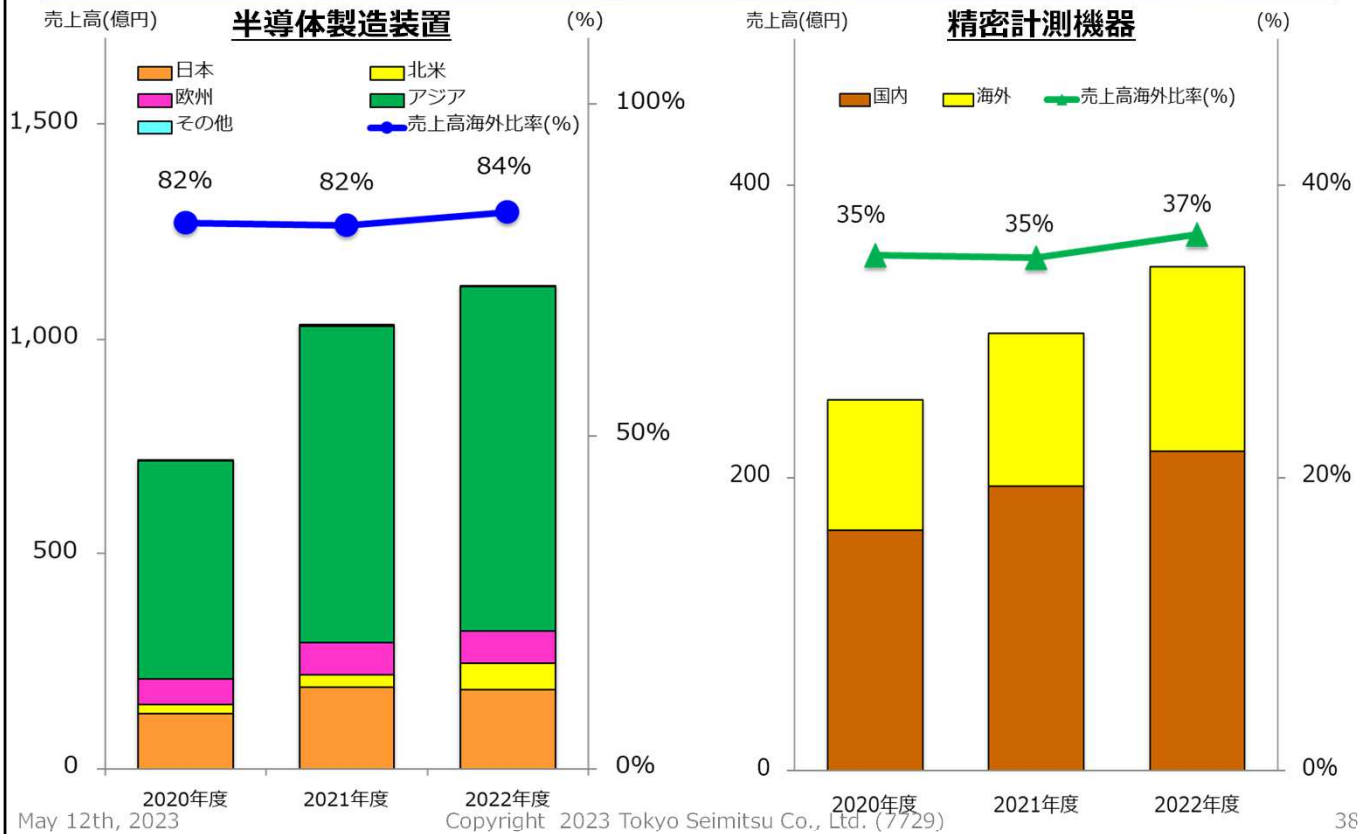
各種費用, キャッシュフロー Expenses and Cash Flows



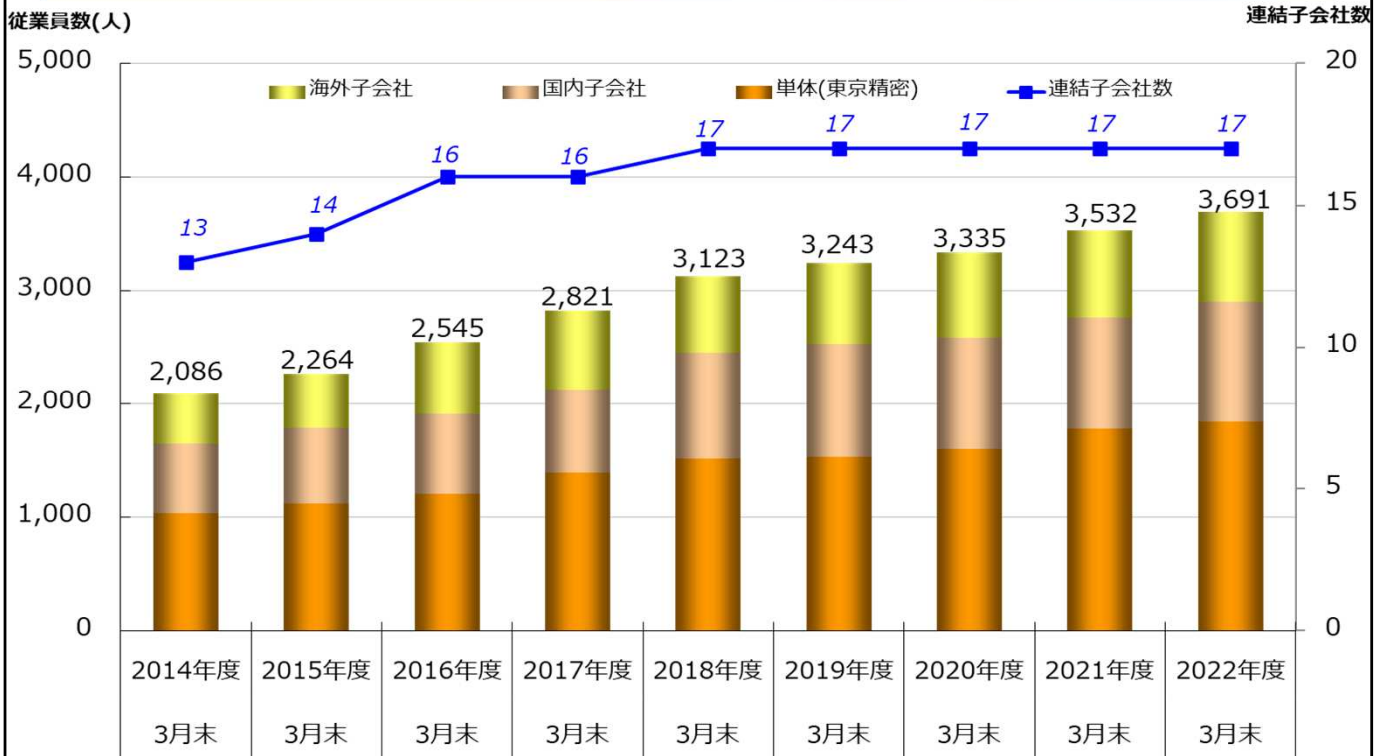
(百万円) (Million Yen)	2020年3月期 FY2020/3	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3
試験研究費 R&D expenses	8,234	7,193	8,146	8,542
設備投資 Capex	7,477	5,950	9,793	9,725
減価償却費 (のれん除く) Depreciation (excl. Amortization)	3,450	3,516	3,551	3,832

(百万円) (Million Yen)	2020年3月期 FY2020/3	2021年3月期 FY2021/3	2022年3月期 FY2022/3	2023年3月期 FY2023/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	5,965	22,062	23,837	1,000
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-6,116	-5,191	-8,990	-8,421
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-150	16,871	14,846	-7,421
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-6,375	-8,282	-10,346	-2,174
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	-159	429	882	625
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	34,605	43,624	49,006	40,036

地域別売上高



従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算